

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1

## IEEE 国際賞、日本人初受賞

半導体パッケージング分野における顕著な貢献を果たした 35 歳以下の研究者として「IEEE EPS Outstanding Young Engineer Award」を受賞

横浜国立大学大学院工学研究院・井上史大准教授は、2022 年 6 月、IEEE（世界最大規模の電気・情報工学分野の学術研究団体）の Electronics Packaging Society より国際賞「Outstanding Young Engineer Award」を授与されました。

2022 年度本賞の受賞は、井上史大准教授が世界で唯一の受賞者となり、かつ 1996 年の賞の開設以来、初めての日本人の受賞となりました。以前より取り組んでいる三次元実装/集積の研究が高く評価されました。今後も世界に向けた半導体技術の開発、産業界への貢献が期待されます。

### 1. IEEE Electronics Packaging Society 「Outstanding Young Engineer Award」賞について

IEEE（アイ・トリプル・イー、Institute of Electrical and Electronics Engineers）は会員の分布、活動は全世界的規模に及び、この種の専門職団体として世界最大規模の学会です。その分科会の一つである Electronics Packaging Society(EPS)は、マイクロシステムのパッケージングと製造における革新的な進歩の研究、設計、開発に従事する科学者とエンジニアのための組織です。本賞は半導体パッケージングにおける発明、技術開発、出版物、または新製品の実装を通じて、IEEE EPS 分野への顕著な貢献を果たした 35 歳以下の研究者に贈呈されるものです。

参考リンク

<https://eps.ieee.org/awards/outstanding-young-engineer-award.html>

### 2. 受賞内容

“For groundbreaking contributions to the development of 3D integration, including electro/electroless deposition, extreme Si thinning, wafer bonding and singulation process”

電子デバイスは国際社会共通の目標である持続可能な社会実現（SDGs）のための根幹技術であるにもかかわらず、その最先端製造技術は限られた大手のデバイス製造企業が極紫外線（EUV）リソグラフィ露光機などの超高額の装置を揃えた製造拠点を形成するなど多額の研究開発とインフラへの投資をしなければ製造不可能となっています。三次元集積化の

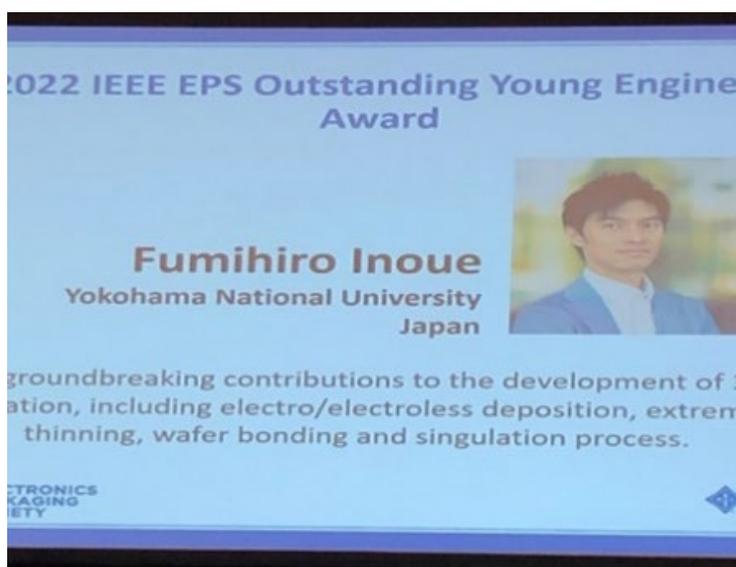
研究開発は、この現状を打破する可能性をもつ技術であり、平面での微細工程に依存せず、デバイスを立体的に積層し高集積化、高速化、低消費電力化を達成可能とします。

上記の三次元集積化の産業化への大きな貢献、幅広いプロセス開発、多数の出版物が評価され、受賞に至りました。



### 3, 授賞式

2022年6月に開催された、世界最大のパッケージング会議 2022 IEEE 72<sup>nd</sup> Electronics Components and Technology Conference (ECTC) in San Diego, USA にて執り行われました。井上准教授は残念ながら参加はかないませんでしたが、授賞式は1500人を超える出席者だったとのことでした。



本件に関するお問い合わせ先

<研究詳細について>

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 井上史大

電話 : 045-339-3861

e-mail [inoue-fumihiko-ty@ynu.ac.jp](mailto:inoue-fumihiko-ty@ynu.ac.jp)

HP: <https://inoue.ynu.ac.jp/>

<報道担当>

横浜国立大学 学長室 広報・渉外係

〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台7-9-1

Tel : 045-339-3027 Fax : 045-339-3179

E-mail : [press@ynu.ac.jp](mailto:press@ynu.ac.jp)